

电子行业周报 (4.22-4.28)

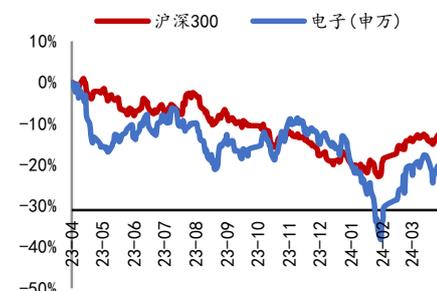
HBM 存储战略要地，大厂加速布局

强于大市(维持评级)

投资要点:

- AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。
- 首先，4月22日消息，SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多的功能，公司可以生产在性能、共享等方面更满足客户需求的定制化HBM产品。除此之外，SK海力士还表示，他们将把下一代后处理技术“混合键合”应用于HBM4产品。与现有的“非导电膜”工艺相比，它提高了散热效率并减少了布线长度，从而实现了更高的输入/输出密度，这会将当前的最大12层增加到16层。
- 其次，4月26日消息，SK海力士宣布，为应对用于AI的半导体需求剧增，决定扩充HBM等新一代DRAM的生产能力，公司将建设在韩国清州市的M15X定为新的DRAM生产基地，并决定向厂房建设投资约5.3万亿韩元。随着AI时代的来临，公司认为，预计年均增长率高达60%以上的HBM、以面向服务器的高容量DDR5模块为主的普通DRAM产品需求将持续增加。在此趋势下，要想确保HBM产品的产量达到与普通DRAM相同的水平，则至少需要相对于普通DRAM至少两倍以上生产能力。公司认为，提高以HBM为主的DRAM产能是其首要课题。
- 再者，4月24日据外媒报导，三星已经成功与处理器大厂AMD签订了价值30亿美元的新供应协议。三星将向AMD供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在AMD Instinct MI350系列AI芯片上。三星于2024年2月正式宣布业界首款HBM3E 12H DRAM，拥有12层堆叠，带宽高达1280GB/s，容量为36GB，是迄今为止带宽和容量最高的HBM产品。HBM3E 12H采用先进的TC NCF薄膜，使12层产品具有与8层产品相同的高度规格，在更高的堆叠上具备优势，同时该TC NCF还通过在芯片之间使用各种尺寸的凸块来提高HBM的热性能。三星强势出击，HBM竞争趋于白热化，各大厂正运筹帷幄，加速推进HBM的迭代与落地。
- 投资建议：**HBM方向，建议关注华海诚科、壹石通、联瑞新材、赛腾股份、华海诚科、德邦科技、雅克科技等；半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、英杰电气、苏大维格等，以及IC封装领域重点公司，如长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。AI应用终端方向，建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、通富微电、龙芯中科、TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达、广信材料等。
- 风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨钟
执业证书编号: S0210522110003
邮箱: yz3979@hfzq.com.cn
联系人 詹小璿
邮箱: ZX30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 《联想发布 AI PC, AI 普惠再下一城》——2024. 04. 22
- 《全球 PC 寒冬渐去, AI PC 开启全新增长》——2024. 04. 14
- 《台湾花莲地震, 关注电子行业供应链安全》——2024. 04. 08

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	8
2.3	消费电子板块.....	9
2.4	汽车电子板块.....	10
2.5	面板板块.....	11
三、	公司动态跟踪.....	12
四、	风险提示.....	13

图表目录

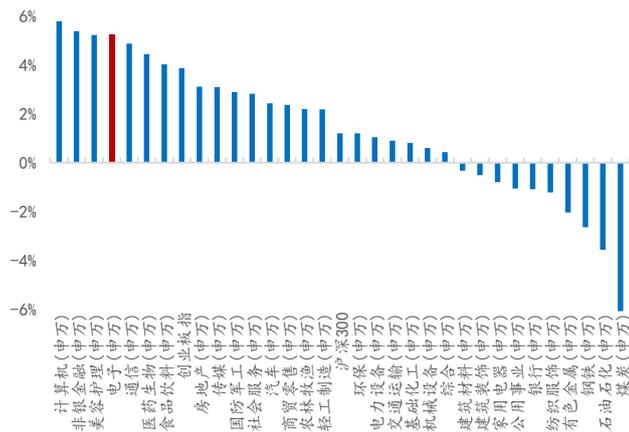
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	12
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	12

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

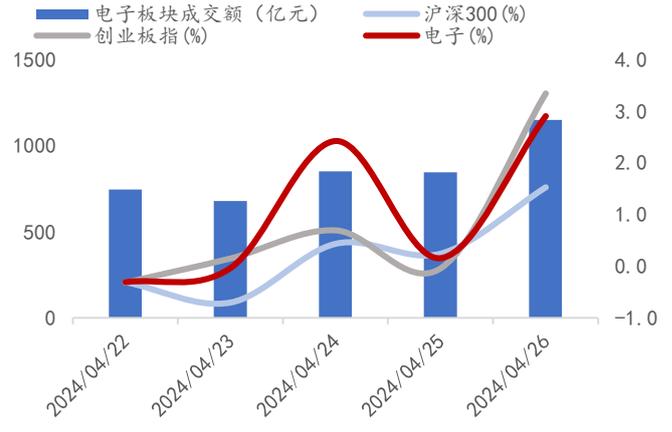
大盘表现上，本周（0422-0426）创业板指数上涨 3.86%，沪深 300 指数上涨 1.20%。本周电子行业指数上涨 5.21%，行业表现上，电子行业位列全行业的第 4 位，本周计算机、非银金融、美容护理板块涨幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

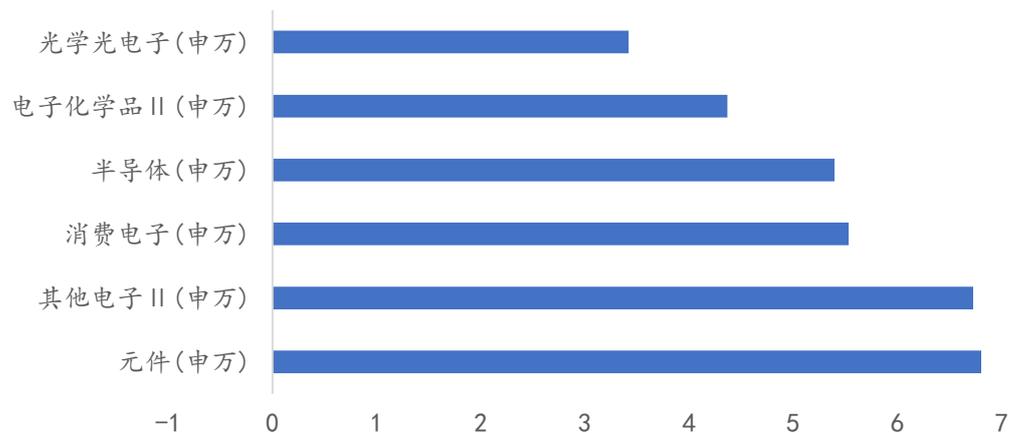
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周光学光电子、电子化学品、半导体、消费电子、其他电子、元件板块均有所上涨，具体来看，元件板块升幅较大，周涨跌幅为 6.80%，其次为其他电子板块，周涨跌幅为 6.73%。光学光电子板块跌涨幅最小，周涨跌幅为 3.42%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

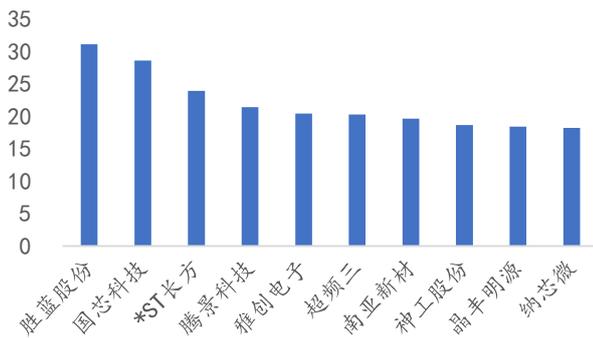


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

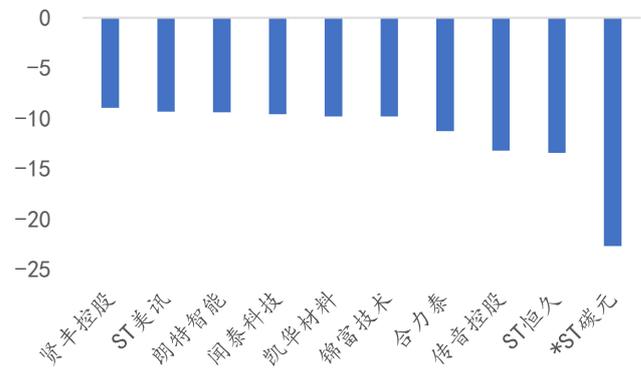
从个股维度来看，SW 电子板块中，胜蓝股份 (31.13%)、国芯科技 (28.61%) 等位列涨幅前列；*ST 碳元 (-22.68%)、ST 恒久 (-13.44%) 等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

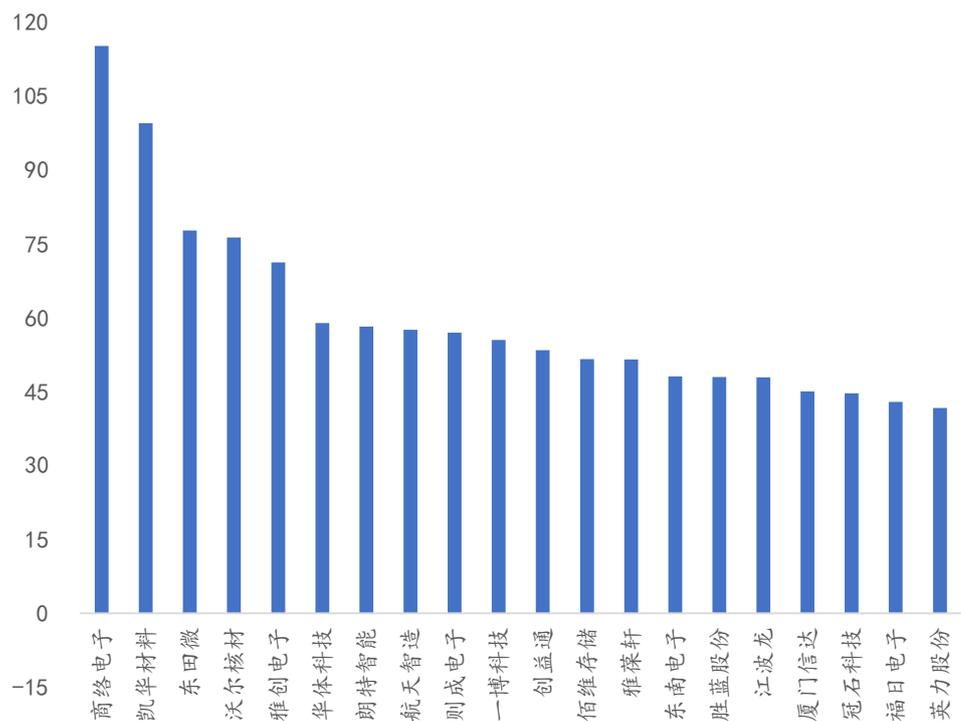
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是商络电子,换手率为 115.19%。其余换手率较高的还有凯华材料(99.52%)、东田微(77.75%)和沃尔核材(76.33%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)

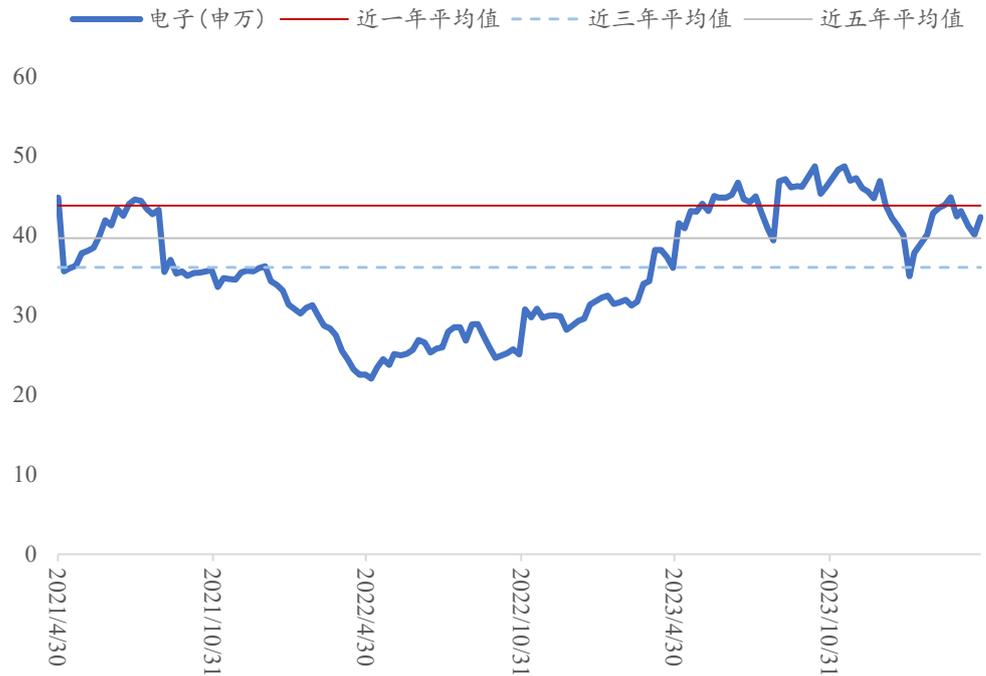


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值高于三年、五年平均值水平,低于近一年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 42.31 倍,较上周有所上升。

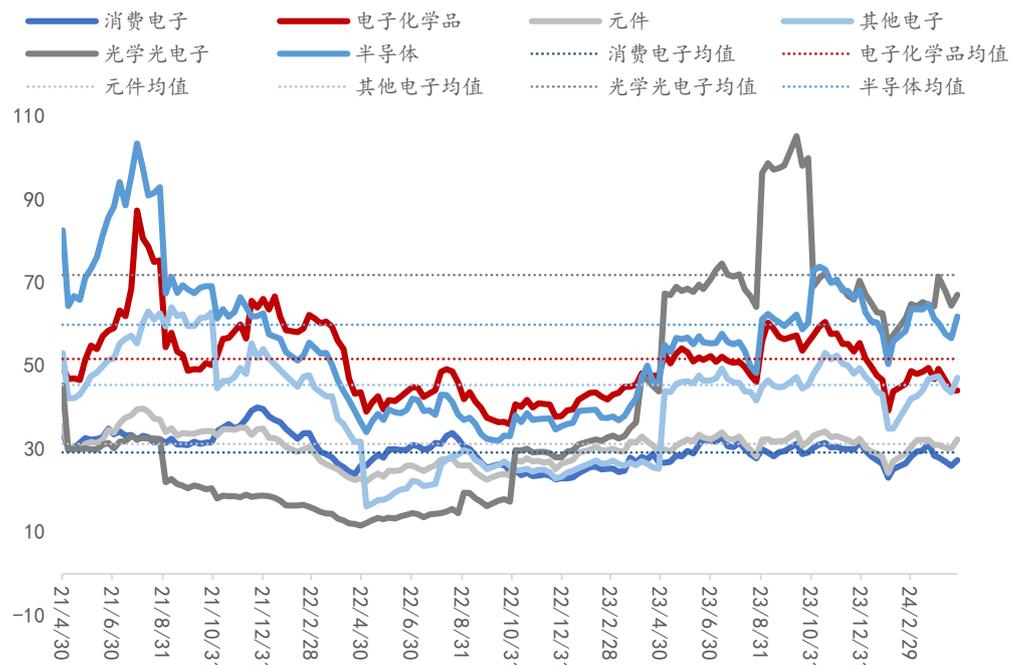
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 近一年消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 均值分别为 29.11、51.60、31.20、45.35、71.76 和 59.84。本周所有电子细分板块估值均有一定程度上升, 其中半导体 PE 涨幅较大。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 台积电官宣 1.6nm，多项新技术同时公布

台积电周三表示，一种名为“A16”的新型芯片制造技术将于 2026 年下半年投入生产，与长期竞争对手英特尔展开对决——谁能制造出世界上最快的芯片。

台积电是全球最大的先进计算芯片合同制造商，也是 Nvidia 和苹果的主要供应商，台积电在加利福尼亚州圣克拉拉举行的一次会议上宣布了这一消息，台积电高管表示，人工智能芯片制造商可能是该技术的首批采用者，而不是智能手机制造商。

分析师告诉路透社，周三宣布的技术可能会让人对英特尔在 2 月份声称的将超越台积电，采用英特尔称之为“14A”的新技术制造世界上最快的计算芯片的说法提出质疑。

台积电业务发展高级副总裁 Kevin Zhang 告诉记者，由于人工智能芯片公司的需求，该公司开发新的 A16 芯片制造工艺的速度比预期更快，但没有透露具体客户的名称。

2) 投资近 280 亿元！SK 海力士于韩国建 HBM 等新一代 DRAM 生产基地

4 月 26 日消息，SK 海力士宣布，为应对用于 AI 的半导体需求剧增，决定扩充 AI 基础设施 (Infra) 的核心产品即 HBM 等新一代 DRAM 的生产能力 (Capacity)。

当天，公司通过董事会决议，将建设在韩国忠清北道清州市的 M15X 定为新的 DRAM 生产基地，并决定向厂房 (Fab) 建设投资约 5.3 万亿韩元 (当前约 279.31 亿元人民币)。

SK 海力士将于本月末开始进行建设工程，计划在 2025 年 11 月竣工并开始量产。公司也将依次进行设备投资，从长远来看，计划向 M15X 投资逾 20 万亿韩元，由此进一步扩充产能。

3) 传三星与 AMD 签订 30 亿美元 HBM3E 出售协议

2023 年 10 月，三星举办了 Samsung Memory Tech Day 2023 活动，宣布推出代号为 Shinebolt 的新一代 HBM3E。到了 2024 年 2 月，三星宣布已开发出业界首款 HBM3E 12H DRAM，拥有 12 层堆叠，容量为 36GB，是迄今为止频宽和容量最高的 HBM 产品。之后，三星开始向客户提供了样品，并计划 2024 年下半年开始大规模量产。

根据外媒报导，三星已经与处理器大厂 AMD 签订价值 30 亿美元的新协议，将供应 HBM3E 12H DRAM，预计会用在 Instinct MI350 系列 AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买 AMD 的 GPU 以换取 HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。

4) 光刻机巨头阿斯麦 ASML 新 CEO 上任，中国业务成首要工作

荷兰光刻机巨头阿斯麦 ASML 迎来了新 CEO，法国人克里斯托夫·富凯 (Chrisophe Fouquet)。

法国媒体在报道这一消息时直言，富凯上任后将面临不少棘手的待办事项，但如何处理公司在华业务则是“首要工作”。

在去年被确认为 ASML 候任 CEO 时，富凯曾表示，“ASML 长期以来一直致力于捍卫公司技术并保持领先地位，这在一定程度上要归功于来自中国等市场的收入并进行再投资。而美国实施的出口管制，将适得其反。”

5) 半导体设备销售，猛升

日本半导体(芯片)制造设备销售旺，3 月份销售额创 11 个月来最大增幅、持续冲破 3,000 亿日圆大关、创下单月历史次高纪录。2024 年 1-3 月期间的销售额创下同期历史新高。

日本半导体制造装置协会(SEAJ)最新公布统计数据指出，2024 年 3 月份日本制芯片设备销售额(3 个月移动平均值、包含出口)为 3,656.80 亿日圆、较去年同月成长 8.5%，连续第 3 个月呈现增长、创 11 个月来(2023 年 4 月以来、成长 9.8%)最大增幅，月销售额连续第 5 个月突破 3,000 亿日圆大关、创下单月历史次高纪录(仅低于 2022 年 9 月的 3,809.29 亿日圆)。

6) 机构：今年全球半导体湿化学品市场将增 8%，达 55 亿美元

半导体材料市场信息咨询公司 TECHCET 预计 2024 年半导体湿化学品市场将增长 8%，规模将达到 55 亿美元。

该机构强调，湿化学品的未来增长将在很大程度上受到前沿设备技术化学品消耗增长的推动，特别是 3D NAND 层数的扩展。

7) SK 海力士 2024 年第一季度收入 12.4296 万亿韩元 创同期历史新高

4 月 25 日消息，SK 海力士发布截至 2024 年 3 月 31 日的 2024 财年第一季度财务报告。公司 2024 财年第一季度结合并收入为 12.4296 万亿韩元，营业利润为 2.886 万亿韩元，净利润为 1.917 万亿韩元。2024 财年第一季度营业利润率为 23%，净利润率为 15%。

公司的 2024 年第一季度收入创历史同期新高，营业利润也创下了市况最佳的 2018 年以来同期第二高，公司将其视为摆脱了长时间的低迷期，开始转向了全面复苏期。

8) 消息称苹果正自主设计 AI 服务器芯片：台积电 3nm 工艺，预估 2025 下半年量产

4 月 24 日消息，消息源 @手机晶片达人近日发布微博，表示苹果公司正在研发自家的 AI 服务器芯片，采用台积电的 3nm 工艺，预估将于 2025 年下半年量产。

注：@手机晶片达人在其账号描述中称在设计集成芯片(IC)方面有 25 年经验，

此前曾在英特尔参与奔腾处理器。

台积电是苹果最重要的合作伙伴，目前大部分的 3nm 产能都是直接供应给苹果公司的。3nm 芯片相比较此前的 5nm / 7nm，性能和能效显著提高。

9) 消息称三星电子 NAND 厂开工率已提高至 90%

集微网消息,据业内人士 21 日透露,近期三星电子 NAND 开工率已提高至 90%,此前存储行业衰退时三星开工率一度下降至 60%。多位知情人士表示,整体工厂平均开工率已达到 90%,一些主要晶圆厂实际上已经“全面开工”了。

10) SK 海力士宣布与台积电合作开发第六代 HBM 产品

4 月 22 日消息,当地时间周五(4 月 19 日),SK 海力士与台积电发布公告,宣布两家公司就整合 HBM 和逻辑层先进封装技术签订谅解备忘录。双方将合作开发第六代 HBM 产品(HBM4),预计在 2026 年投产。

高带宽内存(High Bandwidth Memory)是为了解决传统 DDR 内存的带宽不足以应对高性能计算需求而开发。通过堆叠内存芯片和通过硅通孔(TSV)连接这些芯片,从而显著提高内存带宽。

11) 发出警告信! 美国要求向 600 余家中国公司断供

BIS 于 2024 年 2 月向美国数十家芯片企业发出“危险信号”警告信。信件称,发现“贵公司客户自 2022 年 9 月 15 日以来持续向俄罗斯供货”。

BIS 根据 HS 编码 8542.31 的贸易记录得出这一结论,每家被警告的企业都收到了一份包含 600 多家企业的名单,BIS 要求收到警告信的企业自愿停止供应。

据悉,名单中的 600 多家企业有 95%以上为来自中国、香港的企业。

12) AI 需求推升, 2024 全年 QLC Enterprise SSD 出货位元高速增长

随着节能成为 AI 推理服务器(AI Inference Server)优先考量,北美客户扩大存储产品订单,带动 QLC Enterprise SSD 需求开始攀升。然而,目前仅 Solidigm 及三星(Samsung)已有 QLC 产品获得验证,因此,此波需求将以积极推广 QLC 产品的 Solidigm 受益最大。据 TrendForce 集邦咨询预估,2024 全年 QLC Enterprise SSD 出货位元上看 30EB(EB, Exabyte),较 2023 年增长四倍。

13) 联电: Q2 晶圆出货小增 1-3% 3DIC 解决方案今年量产

晶圆代工厂联电 4 月 24 日召开法说会,总经理王石表示,第二季随着 22/28nm 需求改善,出货量预估季增 1-3%,平均销售单价(ASP)大持平前季,同时 3DIC 解决方案也获得客户采用,首个应用为射频前端模组,预计今年就会量产。

联电预估,第二季晶圆出货量季增 1-3%,ASP 持平,毛利率大致维持 30%,稼动率 64-66%,资本支出维持 33 亿美元的水准。

2.2 AI 板块

1) 机构公布中国人工智能发明专利企业排行榜：华为、OPPO 位列前十

集微网消息，近日 IPRdaily 中文网发布中国人工智能发明专利企业排行榜 (TOP50)，根据榜单显示：腾讯以 15626 件发明专利排名第一；百度以 13723 件发明专利排名第二；平安集团以 13139 件发明专利排名第三。此外，国家电网、华为、蚂蚁集团、阿里巴巴、京东集团、OPPO、中国移动等企业也表现突出，位列前十。

据悉，该榜单基于人工智能技术相关的关键词和分类号进行限定，统计 2014 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日在中国申请并公开的人工智能发明专利（同申请号合并）。

2) 2030 年生成式 AI 市场规模 将达到 1.5 万亿美元

生成式 AI (generative AI) 技术近年崛起，成为全球科技发展的焦点之一。DIGITIMES 分析师黄耀汉观察，生成式 AI 市场目前处于初期阶段，未来全球市场规模将由 AI 运算设备硬件占据，2024 年预估占比高达 95%。黄耀汉预估，2030 年生成式 AI 市场规模将达到 1.5 兆美元，2024~2030 年的年复合成长率(CAGR)达 83%。

3) Meta 今年人工智能相关支出要增加数十亿美元

4 月 25 日消息，当地时间周三，Facebook 的母公司 Meta 公布了第一季度财报，显示公司营收同比增长 27%，利润更是翻了一番多。公司表示，为了支持人工智能领域的发展，计划在基础设施方面的投入将超出预期，增加数十亿美元。

4) 英伟达已向 OpenAI 交付全球首台 DGX H200 由 CEO 黄仁勋亲自交付

4 月 25 日消息，据外媒报道，英伟达已在当地时间周四，在 OpenAI 位于旧金山的办公室，向在人工智能智能领域走在前列的他们交付了全球首台 DGX H200。

英伟达向 OpenAI 交付全球首台 DGX H200，是由 OpenAI 总裁格雷格·布洛克曼(Greg Brockman)在社交媒体上宣布的，他称全球首台英伟达 DGX H200，由黄仁勋亲自交付给 OpenAI，致力于推进人工智能、计算和人类的发展。

2.3 消费电子板块

1) 机构：Q1 中国折叠屏手机出货 186 万台增长 83%，华为第一

集微网消息，研究机构 IDC 统计，2024 年一季度中国智能手机出货约 6926 万台，其中折叠屏手机出货量达到 186 万台，同比增长 83%，在整体智能手机市场占比约为 2.7%。

IDC 表示，从去年下半年的荣耀 Magic V2 系列开始，到本季度的 vivo X Fold3 系列，横向折叠屏手机正在逐渐解决厚重不耐用、续航差、影像与直板机差距大以及价格贵等缺点。这些问题的解决意味着折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，获得更多消费者的认可。

厂商份额方面，华为独占 44.1%位居第一，Mate X5 和新品 Pocket 2 帮助其稳

居折叠屏市场冠军；荣耀得益于 Magic V2 等机型，本季度稳居第二，份额 26.7%；vivo 份额 12.6% 位居第三，近日推出的新品 vivo X Fold3 系列销售超出预期，已开始加单；OPPO 排名第四，份额 9.0%，其中 OPPO Find N3 Flip 在竖折市场份额位居第二；三星位居第五，份额 5.9%；小米、联想（摩托罗拉品牌）份额均不足 1%。

2) 郭明錤：市场需求急剧下滑，苹果下调 Vision Pro 产量至 40~50 万

彭博社日前表示，Apple Vision Pro 似乎正在经历之前每一款 VR 头显的相同脚本：一个令人兴奋的初始发售期，销量激增，用户涌向商店体验，然后热度消退。目前，店内演示的需求正在下降，而预约的人通常不会出现。另外，销售额（至少在一些地方）已经从每天数台变成了一周只有数台。所以，苹果正在加大产品的宣传力度。

现在著名苹果消息人士郭明錤发文称，美国市场需求急剧下滑超过预期，而苹果已经将 Apple Vision Pro 的出货量预测下修至 40 万-50 万。同时，这让苹果连带保守看待非美国市场的需求，并且正在重新检视与调整头显发展蓝图，Apple Vision Pro 在 2025 年可能无新机种出现。

3) 2024 年第一季度国内智能手机市场数据出炉

4 月 23 日，研究机构 Counterpoint 发布的数据显示，2024 年第一季度，中国智能手机市场销量同比增长 1.5%，环比增长 4.6%，连续第二个季度实现同比正增长。

从厂商排名来看，vivo 以 17.4% 的市占率排名第一，荣耀以 16.1% 的市占率排名第二，苹果以 15.7% 的市占率排名第三；第四至六名分别为华为、OPPO、小米，相应的市占率分别为 15.5%、15.3%、14.6%。

4) 苹果公布最新供应链名单：中国大陆 8 家新入列 4 家被剔除

集微网消息，苹果日前公布 2023 财年供应链名单，中国大陆新进 8 家企业，有 4 家企业被剔除。中国台湾供应商新进 2 家企业，同样有 4 家企业被剔除。

其中，中国大陆新进的 8 家企业包括宝钛股份(Baoji Titanium Industry Co., Ltd.)、酒泉钢铁 (Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.)、中石伟业科技 (Jones Tech PLC)、凯成科技 (Paisheng Technology Company)、三安光电 (San'an Optoelectronics Co., Ltd.)、博硕科技 (Shenzhen BSC technology Co., Ltd.)、东尼电子 (Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd.) 以及正和集团 (Zhenghe Group)。被剔除的 4 家中国大陆企业为江苏精研科技 (Jiangsu Jian Technology Company Limited)、美盈森集团 (MYS Group Company Limited)、深圳市得润电子 (Shenzhen Deren Electronic Company Limited) 以及盈利时 (Winox Holdings Limited)。

2.4 汽车电子板块

1) 雷军：小米 SU7 毛利率 5-10% 目标 15-20 年成为全球前五车厂

4 月 23 日消息，刚刚雷军官微发布信息，小米集团举办了投资者大会。雷军向投资者朋友们分享了小米 SU7 的最新进展：截止 4 月 20 日，小米 SU7 的锁单量已超过 7 万台，我们正在全力扩充产能，今年交付目标 10 万台。

谈到小米 SU7 的毛利率，雷军表示：“我真的特别感谢供应商，他们从第一天起，就相信小米汽车能成，给了我们非常好的成本和支持。我预计大概毛利率会在 5-10%。”。

谈到小米汽车业务部署，雷军称，未来三年里会 100 % 聚焦在国内市场，把中国市场做好是我们的第一步。同时因为我们业务收入有一半来自于全球市场，我们在 100 多个国家做生意，30 多个国家有办事处、分公司，我们拥有全球影响力和全球米粉基础，等我们准备好以后做全球市场应该是水到渠成的。

另外，雷军还透露，今年我们在包括汽车在内的新业务上，还要投 110 亿 - 120 亿，同时底层的操作系统等几个关键领域还会进一步加大投入。我的目标不是低水平盈利，我的目标是 15-20 年成为全球前五的车厂，成为新一代的全球硬核科技引领者。

2) 特斯拉第一季度营收 213.01 亿美元同比下降 9%，净利润同比下降 55%

4 月 24 日消息，特斯拉今天盘后发布了 2024 年第一季度财报，详细介绍了该季度业绩表现。

这份财报公布之前，特斯拉刚刚经历了一个充满挑战的季度。当季特斯拉生产了 43.33 万辆汽车，交付了 38.68 万辆，低于分析师此前预期的 44.91 万辆交付量和 45.29 万辆产量。特斯拉在第一季度汽车交付和生产报告中指出，导致产量和交付不及预期的部分原因在于弗里蒙特工厂对 Model 3 进行升级换代的初期阶段，以及红海冲突导致的航运改道停产和柏林超级工厂的纵火袭击事件。

2.5 面板板块

1) 2024 年 4 月下旬面板价格趋势

根据 TrendForce 集邦咨询旗下面板研究中心调研数据，2024 年 4 月下旬，电视、显示器面板价格延续上涨趋势，部分笔记本面板价格小幅上涨。

2) 集邦：4 月电视面板需求转弱 大尺寸有撑

研调机构集邦科技表示，电视面板需求进入 4 月后开始出现疲软迹象，55 吋以下需求走弱的讯号较明显，仅 65 吋以上大尺寸电视面板，仍有后续旺季促销备货需求支撑。

集邦研究副总经理范博毓评估，目前面板厂的稼动率仍处于较高的水准，供给能力增加下，面板价格的涨势开始出现收敛。以 4 月电视面板价格而言，32 吋、43 吋、50 吋预计上涨 1 美元，55 吋预计上涨 2 美元，65 吋、75 吋预计上涨 4 美元到 5 美元。

范博毓表示，液晶显示器 (Monitor) 面板受电视面板价格上涨的激励，3 月起成功调涨价格，4 月后部分品牌客户就消费性机种的备货需求仍然强劲。

3) 传 12.9 英寸 iPad Air 将升级采用 Mini LED 屏幕

市场大多认为，苹果将为今年最新的 iPad Pro 机型换成 OLED 显示屏，不过在 DSCC 首席执行官 Ross Young 进一步表示，传闻中的 12.9 英寸 iPad Air 预计将于 5 月发布，而 12.9 英寸 iPad Air 将搭载 Mini LED 显示屏，就像是先前的 12.9 英寸 iPad Pro 一样。做为比较，现有的 10.9 英寸 iPad Air 采用 LCD 面板。

Ross Young 认为，12.9 英寸 iPad Air 将使用过往 12.9 英寸 iPad Pro 剩余的 Mini LED 备料，好处是可为 iPad Air 带来较低功耗的好处。

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量 上限	拟变动数量上限占 总股本比(%)
603685.SH	晨丰科技	2024-04-25	减持	杭州宏沃自有资金投资有限公司	5%以上非第一大股东	1,690,000.00	1.00
603989.SH	艾华集团	2024-04-23	增持	湖南艾华控股有限公司	控股股东	/	/
002185.SZ	华天科技	2024-04-24	增持	天水华天电子集团股份有限公司	控股股东	/	/
003019.SZ	宸展光电	2024-04-23	增持	宝德阳科技(厦门)有限公司	实际控制人的一致行动人	/	/
301182.SZ	凯旺科技	2024-04-22	减持	河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙),河南省返乡创业股权投资基金(有限合伙)	股东	958,217.00	1.00
831167.BJ	鑫汇科	2024-04-26	减持	深圳市投控东海中小微企业创业投资企业(有限合伙)	上市前持股 5%以上股东	499,800.00	1.00
002881.SZ	美格智能	2024-04-25	减持	深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	持股 5%以上股东	3,763,800.00	1.44
002981.SZ	朝阳科技	2024-04-24	减持	宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)	股东	2,880,000.00	3.00
002475.SZ	立讯精密	2024-04-27	增持	王来胜	实际控制人之一,副董事长	/	/
688106.SH	金宏气体	2024-04-26	减持	师东升	董事,监事,高级管理人员	28,600.00	0.01

数据来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时总 股本比例(%)	期权初始行 权价格
300054.SZ	鼎龙股份	2024-04-26	董事会预案	授予期权,行权股票来源为上市公司定向发行股票	2,500.00	2.6435	19.03
300576.SZ	容大感光	2024-04-26	董事会预案	上市公司定向发行股票	255.00	1.0348	20.13

301297.SZ	富乐德	2024-04-26	董事会预案	上市公司定向发行股票	825.00	2.4380	10.80
603228.SH	景旺电子	2024-04-23	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	755.79	0.8977	15.82
603228.SH	景旺电子	2024-04-23	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	1,484.11	1.7629	9.89
688183.SH	生益电子	2024-04-27	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	4,159.11	5.0000	5.01
688416.SH	恒烁股份	2024-04-24	董事会预案	上市公司定向发行股票	120.00	1.4521	23.72
300236.SZ	上海新阳	2024-04-23	实施	股票增值权	25.78	0.0823	17.34
833346.BJ	威贸电子	2024-04-26	股东大会通过	上市公司定向发行股票	125.00	1.5500	9.00
300102.SZ	乾照光电	2024-04-22	实施	上市公司提取激励基金买入流通股	3,200.00	3.5043	3.57
300236.SZ	上海新阳	2024-04-23	实施	股票增值权	25.78	0.0823	17.34
603893.SH	瑞芯微	2024-04-26	实施	上市公司定向发行股票	15.00	0.0359	34.27
688391.SH	炬泉科技	2024-04-27	实施	上市公司定向发行股票	105.00	1.2572	23.40

数据来源：Wind，华福证券研究所

四、风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn